

Intel gravera des composants ARM en 10 nm

Intel franchit une nouvelle étape dans l'ouverture de ses usines de production de composants à des acteurs tiers. Le géant des semi-conducteurs vient en effet de signer un accord avec **ARM** permettant aux sociétés utilisant cette technologie d'accéder à ses futures usines **10 nm FinFET**.

Cette décision de la part d'Intel est logique. La firme ne peut en effet plus faire cavalier seul sur le terrain de la production de composants. Car, à mesure que la finesse de gravure des composants progresse, **le coût des usines explose**. Il faut donc en maximiser l'usage, en permettant à d'autres sociétés d'y accéder. Cette nouvelle décision permettra à Intel de lutter à armes égales avec les pure players du secteur, dont TSMC.

Un long chemin reste toutefois à parcourir pour la firme, qui ne propose à ce jour que du **22 nm** et du **14 nm** à ses clients. Pour le 10 nm, il faudra encore attendre, même si la société entend bien ne pas se faire doubler par son très agressif concurrent TSMC.

LGE, premier sur le 10 nm FinFET d'Intel

LG Electronics est le premier client d'Intel qui utilisera le 10 nm FinFET pour des composants ARM mobiles.

D'autres sociétés font également appel à la firme pour leurs puces : **Spreadtrum**, pour des composants ARM mobiles gravés en 14 nm ; **Achronix Semiconductor**, pour ses FPGA réseau Speedster22i en 22 nm ; **Netronome**, pour les composants réseau NFP-6480, là aussi gravés en 22 nm ; **Altera**, pour ses FPGA 14 nm.

À lire aussi :

[Avec Zen, AMD dégage son ultime arme contre Intel](#)

[Intel commence à livrer ses processeurs Kaby Lake](#)

[Intel ne redresse pas la barre, malgré les licenciements](#)